

2025 기업가치 제고(Value-up) 이행 현황

2025.11

We Do Technology
첨단기술의 중심, 더 나은 세상을 만들습니다.



Disclaimer

본 자료는 SK하이닉스(주) (이하 "회사")의 미래에 대한 예상, 전망, 계획, 기대 등의 '예측정보'를 포함하고 있으며
이러한 '예측정보'는 그 성격의 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래실적과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

본 자료의 내용은 회사의 약속이나 진술로 간주될 수 없으며, 어떠한 경우에도 투자자들의 투자판단 및 그 결과에 대한 법적 책임의
증빙자료로 사용될 수 없습니다.

회사는 본 자료와 관련하여 어떠한 의무나 책임을 부담하지 않음을 알려드립니다.

CONTENTS

2025 기업가치 제고(Value-up) 이행 현황

① Overview

- 주요 지표 현황
- 목표 이행 현황

② 이행 현황

- 목표별 이행 현황
 - CapEx Discipline
 - Tech Roadmap
 - 재무 건전성 강화

2025 기업가치 제고(Value-up) 이행 현황

CHAPTER

01

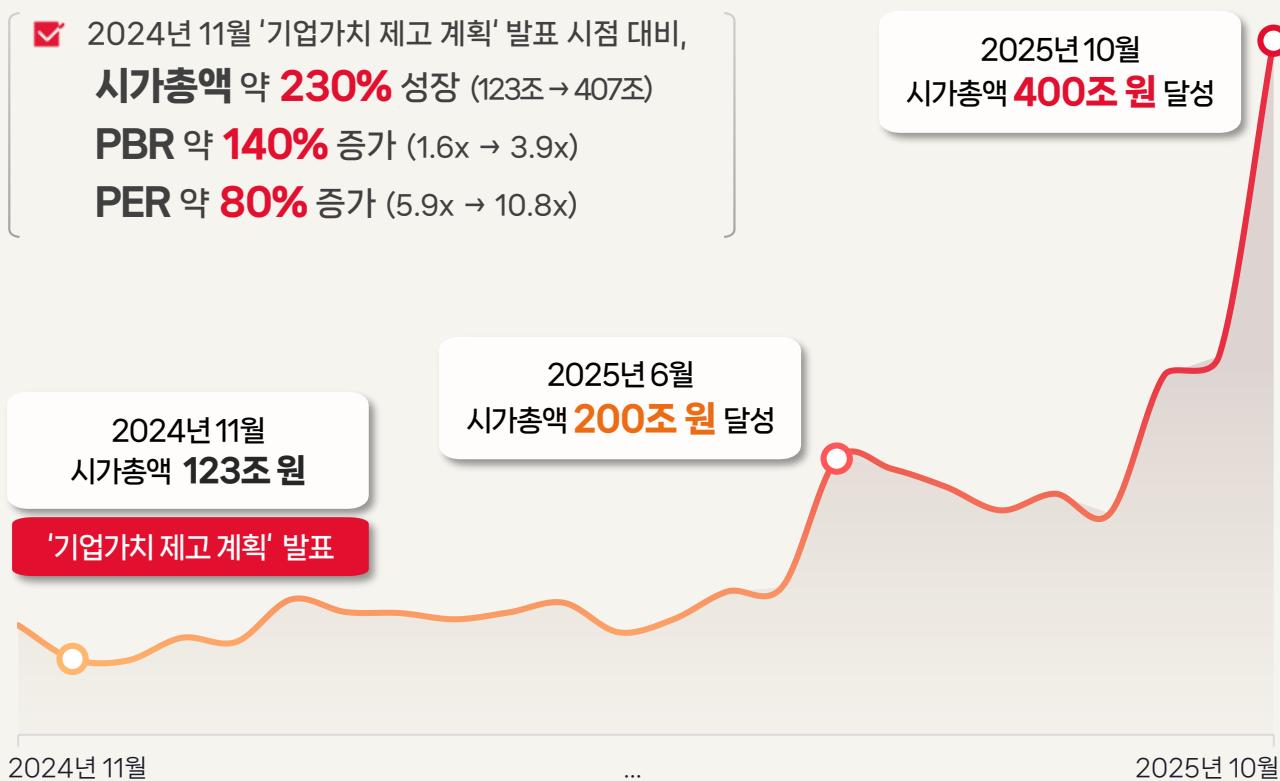
Overview

- 주요 지표 현황
- 목표 이행 현황

주요 지표 현황

기업가치 제고 현황

- 2024년 11월 '기업가치 제고 계획' 발표 시점 대비,
시가총액 약 230% 성장 (123조 → 407조)
- PBR 약 **140%** 증가 ($1.6x \rightarrow 3.9x$)
- PER 약 **80%** 증가 ($5.9x \rightarrow 10.8x$)



재무 지표 현황(2025년 3분기 말 기준)

현금*

27.9조 원
+ 13.7조 원

2024년 말 대비

순차입금

순현금 3.8조 원
- 12.3조 원

2024년 말 대비

ROE

43.2%
+ 12.1%p

2024년 말 대비

주주환원

7,771억 원
+ 1,572억 원

2024년 동기 대비

*현금=현금 및 현금성자산+단기금융상품+단기투자자산

* 각 회계연도 1,2,3분기 현금배당 결정 금액의 합계

(Source: SK hynix, 한국거래소)

목표 이행 현황

2024년 11월 중장기 기업가치 제고 계획을 발표하고 지속적으로 이행하고 있습니다.

기업가치 제고 목표

**균형잡힌
CapEx Discipline 실행**
CapEx/Revenue 30% 중반 목표
(3개년 이동평균)

**독보적인
Tech Leadership 구축**
기술 및 제품개발 Roadmap 달성

**재무 건전성
강화**
재무 건전성 확보와 주주환원 확대를
균형 있게 추진

2025년 이행현황

산업 내 최적의 수급 균형을
유지하기 위한 중기 목표 이행

- 2025년 3분기 누적 CapEx 17.83조원*
- 2025년 3분기 누적 매출 64.32조원

~2029년 Tech Roadmap 달성

- 2024.11 세계최초 321단 낸드 양산 돌입
- 2025.08 321단 QLC 낸드 양산 개시
- 2025.09 세계최초 HBM4 개발 및 양산 체제 구축

재무구조 개선	주주환원
<ul style="list-style-type: none"> • 부채비율 감소 (62% → 48%) • 순현금 달성 (2025년 3분기) 	<ul style="list-style-type: none"> • 고정배당금 확대 (25%↑) • 배당 예측 가능성 제고

*유형자산 취득 기준

2025 기업가치 제고(Value-up) 이행 현황

CHAPTER

02

이행 현황

- 목표별 이행 현황
 - CapEx Discipline
 - Tech Roadmap
 - 재무 건전성 강화

목표별 이행 현황 — CapEx Discipline

- ✓ 산업 내 최적의 수급 균형을 유지하기 위한 중기 목표를 이행하고 있습니다.

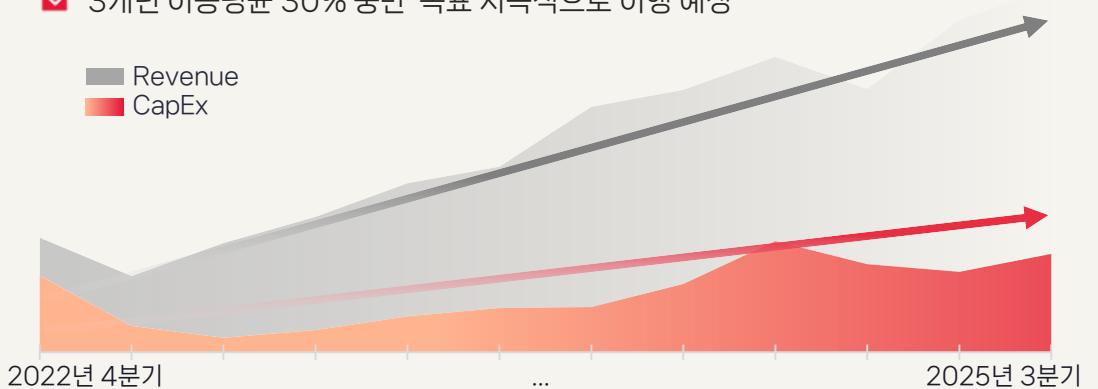
CapEx Discipline



매출 대비 CapEx 집행 현황

- ✓ 매출 급증으로 2025년 3분기 기준 3개년(이전 12분기) 평균 **27.8%** 수준 집행
- ✓ '3개년 이동평균 30% 중반' 목표 지속적으로 이행 예정

Revenue
CapEx



	2024	2025 3Q	2026	...
CapEx*	17.95	17.83	...	이동평균 30% 중반 목표 지속
Revenue	66.19	64.32	...	

* 유형자산 취득 기준

목표별 이행 현황 — Tech Roadmap

본원적 경쟁력을 기반으로 AI 메모리 선두주자로 흔들림 없이 나아가겠습니다.

~2029 Tech Roadmap

AI Memory

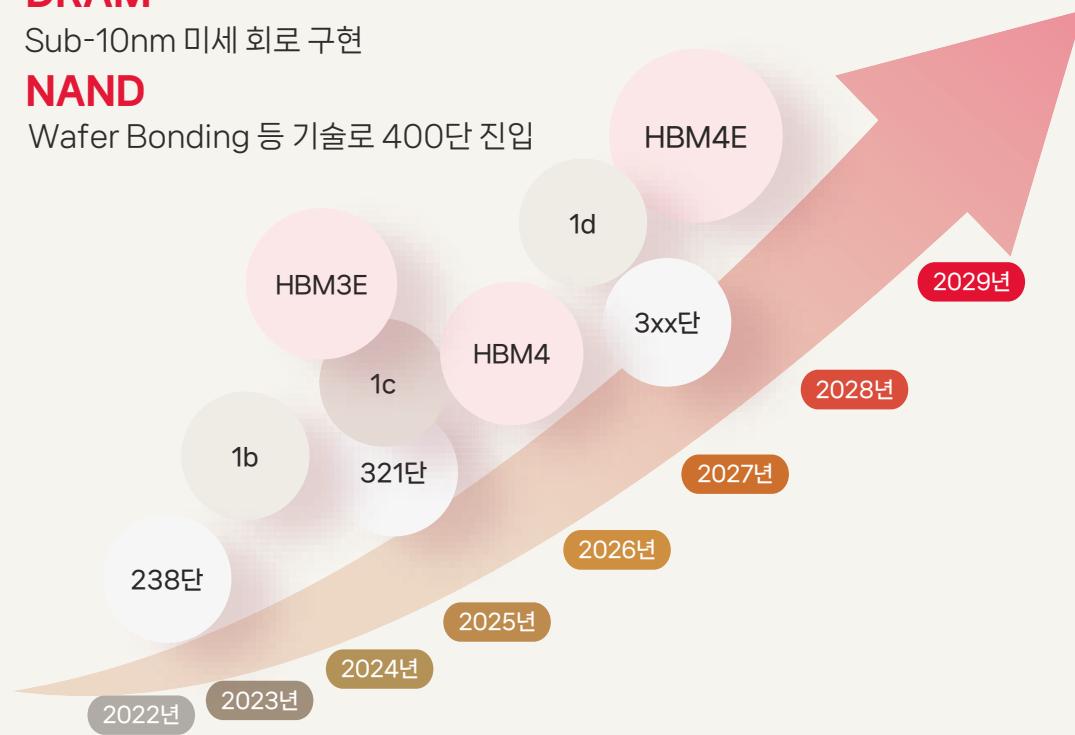
Hybrid Bonding으로 20단 이상 Stack-up

DRAM

Sub-10nm 미세 회로 구현

NAND

Wafer Bonding 등 기술로 400단 진입



~2025 Development



2025.09 세계 최초 HBM4 개발 완료 및 양산 체제 구축

2025.08 321단 QLC 낸드 양산 개시

2025.05 321단 낸드 기반 UFS 4.1 설루션 제품 개발

2025.03 세계 최초 12단 HBM4 샘플 공급

2024.11 세계 최초 321단 낸드 양산 돌입

2024.09 세계 최초 12단 HBM3E D램 양산 돌입

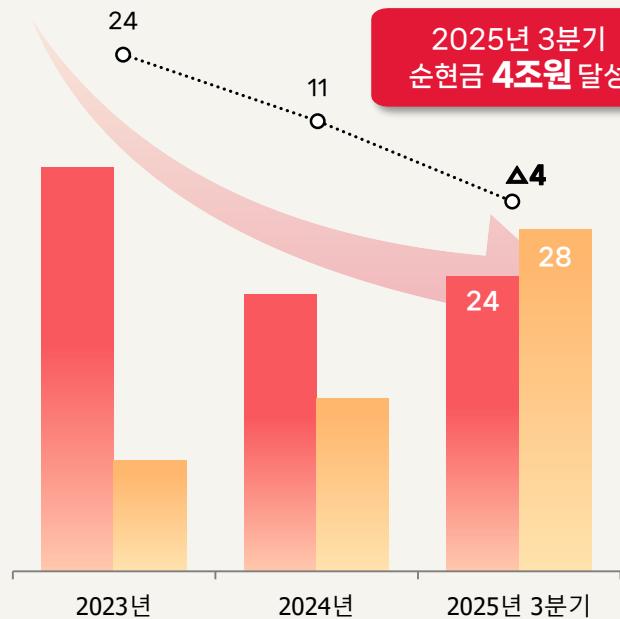
목표별 이행 현황 — 재무 건전성 강화

- ✓ 2025년 3분기 Net Cash를 달성하는 등 재무구조를 개선하였습니다.
향후에도 업황 변동성을 극복하고 안정적인 사업운영을 위해 재무 건전성을 강화하기 위한 노력을 지속하겠습니다.

순차입금

(단위: 조 원)

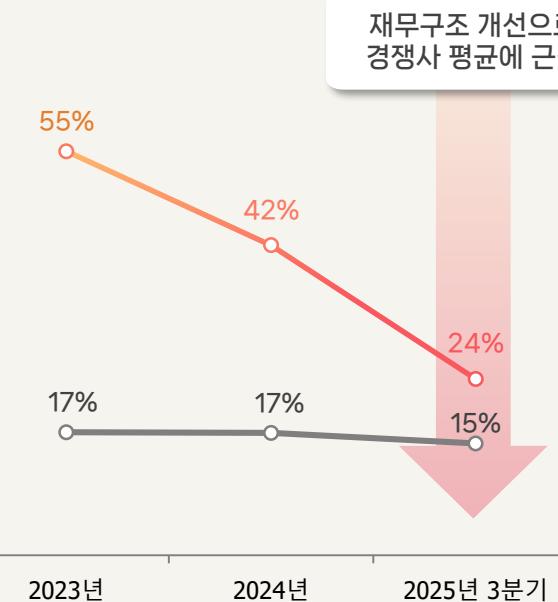
... 순차입금 ■ 차입금 □ 현금



차입금 비율

경쟁사와의 차입금 비율 비교

—SK하이닉스 —경쟁사 평균



신용 등급 현황

국내외 신용평가사 등급전망 '긍정적' 상향

해외 신용 등급

신용평가사	Moody's	S&P Global	Fitch
신용등급	Baa2	BBB	BBB
등급전망	'Stable' → 'Positive' ('25.7~8월)		

국내 신용 등급

신용평가사	NICE신용평가	한국기업평가	한국신용평가
신용등급	AA	AA	AA
등급전망	'안정적' → '긍정적' ('25.10월)		

목표별 이행 현황 — 재무 건전성 강화

배당절차를 개선하여 배당 예측가능성을 제고하였으며, 신규 주주환원 정책을 준수하여 배당을 지급하고 있습니다.

주주환원정책 이행사항

배당절차 개선 (2024.03.27)

- 배당기준일을 배당액 결정 이후로 정할 수 있도록 배당절차를 개선하여 배당 예측가능성 제고

	배당액 확정일	배당기준일
제77기 결산배당*	2025.01.23	2025.02.28
제78기 1분기 배당	2025.04.23	2025.05.31
제78기 2분기 배당	2025.07.23	2025.08.31
제78기 3분기 배당	2025.10.29	2025.11.30

* 결산배당 금액을 결정한 이사회 일자를 기재하였으며, 2025.03.27 제77기 정기주주총회에서 최종 확정됨

2025-2027 주주환원 정책 시행 (2024.11.27)

고정배당금

- 연간 고정배당금 25% 상향 (1,200원 → 1,500원)



추가 환원

- 재무 건전성 목표 달성을 시, 3년 누적 FCF의 50% 범위 내 추가 환원
 - Net Cash 전환과 적정 수준의 현금 확보
- 유의미한 수준의 FCF가 창출될 경우, 일부 조기 환원 여부를 검토

2025 기업가치 제고(Value-up) 이행 현황

